## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-220990

(43)Date of publication of application: 18.08.1995

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number: 06-008136

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

28.01.1994

(72)Inventor:

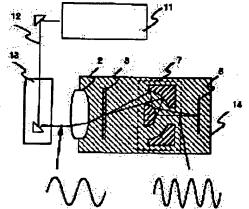
FUKUDA HIROSHI

TANAKA TOSHIHIKO

## (54) PATTERN FORMING METHOD AND EXPOSURE APPARATUS THEREFOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by forming a projection optical system of an optical system having a reflection type lens, and fully filling entirety or part of an optical path of the projection system included between a surface of a board and the projection system with medium having 1 or more of specific refractive index to the air in the wavelength of a light. CONSTITUTION: A beam 12 generated from a KrF excimer laser 11 is emitted to a mask 3 via a beam shaping optical system 13 and an illumination optical system 2. A light passing through the mask 3 is exposed on a board 5 via a reflection type contraction projection lens 7. The lens 7 is a Schwarzschild type optical system having a numerical aperture of 0.3 to focus the mask 3 on the board 5. The entire system from the irradiating side of the illumination system to the board via the mask is installed in a liquid vessel 14, and water is fully filled in the vessel to fill the water in the optical path. Then, a pattern is transferred to a positive resist film coating the Si board by using a projection exposure apparatus to form a 0.35μmL/S pattern.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平7-220990

(43)公開日 平成7年(1995)8月18日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号 7352-4M 7352-4M	FI			技術表示箇所	
H01L 21/027 G03F 7/20	5 2 1		.H01L	21/ 30 5 1 8 5 1 5 D		D	
			審査請求	未開求	請求項の数5	OL (全 5 頁)	
(21)出願番号	特爾平6-8136		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所			
(22)出顧日	平成6年(1994)1月28日			東京都千代田区神田駿河台四丁目 6			
			(72)発明者	東京都		多1丁目280番地 央研究所内	
			(72)発明者	東京都		盛 1 丁目280番地 央研究所内	
			(74)代理人	井理士	小川 勝男		

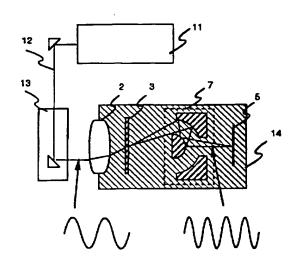
## (54) 【発明の名称】 パターン形成方法及びその露光装置

## (57)【要約】

【構成】マスクパターン3を反射型レンズ7により基板5上へ結像させ、基板5の表面と反射型レンズ7の間を含む露光光学系の光路の全体又は一部を、露光波長における屈折率が1より大きな液体で満たす。

【効果】簡便に実効的に短波長化したのと同等の解像力向上効果を得ることができ、光リソグラフィの解像限界を30%程度向上し、0.15  $\mu$ m 以下のパターンを形成することができる。

図1



10

#### 【特許請求の箆囲】

ì

【開求項1】光源を発した光を照明光学系を介してマスクに照射し、上記マスク上のパターンを投影光学系により基板上へ結倒させることにより上記基板上にパターンを形成する方法において、上記投影光学系を反射型レンズを含む光学系により和成し、少なくとも上記基板と上記投影光学系の間を含む上記投影光学系の光路の全体又は一部を、上記光の波長における空気に対する比屈折率が1より大きな嫉慨で満たすことを特徴とするパターン形成方法

【闘求項2】闘求項1において、上記媒質は液体である パターン形成方法。

【財求項4】光源を発した光を照明光学系を介してマスクに照射し、上記マスク上のパターンを投影光学系により基板上へ結偽させることにより上記基板上にパターンを形成する際に用いられる優光装置において、上記投影光学系を反射型レンズを含む光学系により構成し、上記基板と上記投影光学系の間を含む上記投影光学系の光路 20の全体又は一部を、上記光の波長における空気に対する比屈折率が1より大きな媒質で満たしたことを特徴とする投影優光装置。

【請求項5】請求項4において、上記投影光学系と前記 基板の間に、透明な隔壁を設け、上記媒質を光学系側と 基板側に分割する投影像光装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種固体素子の微細パターンを形成するためのパターン形成方法、及びこれに 30 用いられる投影路光装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】LSI等の固体案子の集積度及び動作速度を向上するため、回路パターンの微細化が進んでいる。現在これらのパターン形成には、量産性と解像性能に優れた縮小投影隊光法が広く用いられている。

【0003】図2(b)に縮小投影露光法の光学系を模式的に示す。二次光源面上の有効光源1を発した光は照明光学系2を介してマスク3に照射され、マスク3上のパターンにより回折された光は縮小投影レンズ4により基板5上へ結倒される。縮小投影レンズは通常屈折型レンズの組合せからなるものが用いられる。この方法の解像限界は電光波長に比例し、投影レンズの開口数(NA)に反比例するため、高NA化と短波長化により解像限界の向上が行われてきた。従来、露光光は、高圧水銀ランプのg線(波長436nm),i線(波長365nm)が用いられてきたが、64メガピットDRAM以降回路寸法が光の波長より小さくなり、物理的限界に遠している。

【0004】一方、顕微鏡等の光学系の実効的なNAを 50

増大させる方法として、液浸(油浸)法が知られている。この方法は、レンズの先端と試料の間に空気より大きな屈折率nを有する液体(通常油を用いる)を充填することにより、実効的に光の波長を1/nとして解飲度を向上させる。この方法の、光リソグラフィへの応用は、例えば、第53回応用物理学会学術解演会開演予稿集、第2分冊、第472頁(1992年)に給じられている。

2

[0006] ステップアンドスキャン方式の光学系は、例えば、レジスト材料プロセス技術(技術情報協会, 京京, 1991年)第12頁から第14頁に給じられている。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上配の従来 液浸法で用いられる顕微鏡等の屈折型対物レンズは、レ ンズ先端と試料の間に所定の屈折率の液体を充填するこ とを前提として専用に設計されたものである。この事情 は投影露光用レンズの場合も同様であり、液浸対応の投 影レンズは従来レンズとは全く異なる設計をもつ専用レ ンズとして特別に設計する必要がある。ここで、仮に液 浸用以外の従来型屈折レンズの先端と基板(又は試料) の間の液体充填領域 6 (図 2 (b)斜線部分)に屈折率 nの液体を充填したとする。この場合、波長は実効的に 1/nになるが、スネルの法則に従いレンズ先端におけ る屈折角が減少するため、光線の光路は図2 (b) の破 線の様に変化して実効的なNAが減少する。このため、 必ずしも解像度は向上しない。しかも、ステッパ用レン ズにおいて要求される広い図光面積を、液浸レンズ特有 の大きなNAと両立させるのは極めて困難であるという 問題があった。

【0008】一方、光リソグラフィの解像度をさらに向上するには、露光波長をできるだけ短くすることが好ましい。しかし、従来型屈折光学系による露光法、反射型投影露光法のいずれも、光学材料の透過率の限界からArFエキシマレーザ(波長193nm)が実用的な短波長化の限界となってしまうという問題があった。

【0009】本発明の目的は、従来型の露光装置の构成

と光学系を大きく変更することなく、簡便に実効的に短波長化したのと同等の解像力向上効果を得て、広い匈光領域を確保しつつ投影図光法の解像度を極限まで向上することが可能なパターン形成方法を提供することにある。

## [0010]

#### [0011]

【0012】また媒質は、露光波長に対する屈折率ができるだけ大きいことが望ましく、十分な解像度効果を得るために、1.2以上であることが望ましい。又、風光波長に対して実質的に透明で、かつ、光学素子及びレジストに悪影響を与えないことが望ましい。具体的には、例えば、水、又はアルコール、直鎖炭化水素等の有機溶媒、シリコーン樹脂、更に無機化合物又は有機化合物をこれらに溶解した液体、又、従来液浸顕微鏡や液浸屈折率測定法等において使用されている各種液体等を用いる40ことができる。

【0013】なお、光学系中で媒質の温度や密度等のゆらぎにより屈折率が変化すると、光学系の結像特性に悪影響を及ぼす恐れがあるため、これら温度等は注意深く制御することが望ましい。特に、走査光学系では光学系に対して基板を走査するので、媒質の流れにより結像特性が変化しないように気を付けることが好ましい。

#### [0014]

## 【実施例】

(実施例1) 本発明の一実施例による反射型投影露光装 50

置を図1に示す。KrFエキシマレーザ11から発生したレーザ光12を、ビーム盛形光学系13及び照明光学系2を介してマスク3に照射する。マスクを通過した光は反射型縮小投影レンズ7を介して基板5を腐光する。反射型縮小レンズは関口級0.3 のシュパルツシュルド型光学系で、マスク3を基板5上に結倒させる。但し、図中の光学系はあくまで模式的なものであり、実際の光学系の构成を忠実に示したものではない。ここで、照明光学系の射出側からマスクを経て基板に至る光学系の全体を液体容器14の内部に設置し、液体容器中に水を満たして光路を水で充填した。

【0015】次に、投影図光装置を用いて、S1基板上に塗布したポジ型レジスト膜(PMMA, 膜厚 $1\mu$ m) に様々な寸法のパターンを伝写した結果、 $0.35\mu$ mL/Sパターンを形成できた。比較のため、光学系から水を除去し空気中で露光を行ったところ解像限界は $0.5\mu$ mに後退した。

【0016】なお、母光装置の液長、光源の種類、投影レンズの方式及び開口致、媒体の種類、使用するレジストプロセス、マスクパタン寸法等、本実施例に示したものに限定しない。例えば、エキシマレーザの代わりに、高圧水銀ランプやキセノン水銀ランブを用いてもよい。又、液体溶液中に水に代えて、パーフルオロアルキルボリエーテル等を用いてもよい。この液体は、母光液長に透明であるとともにレジストの感光特性に全く影母を与えなかった。又、レジストとしても、PMMAに代えて適当なノボラック系ポジ型レジストや化学増幅系レジスト等を用いてもよい。

【0017】(実施例2)本発明の第二の実施例による) 反射型投影露光装置を図3に示す。ArFエキシマレーザ(図示せず)から発生したレーザ光を、ビーム整形光学系及び照明光学系(図示せず)を介してマスク3に照射する。マスクを通過した光は走査型反射光学系21を介して基板5を露光する。走査型反射光学系は閉口致0.7のステップアンドスキャン型光学系で、マスク3を基板5上に結像させる。但し、図中の光学系はあくまで模式的なものであり、実際の光学系の構成を忠実に示したものではない。ここで、投影光学系の光路内の図中斜線で示した領域22に水を充填した。

【0018】次に、投影 風光装置を用いて、Si基板上に塗布したポジ型レジスト膜(PMMA,膜厚1μm)に、様々な寸法のパターンを 広写した 結果、0.11μm L/S パターンを形成できた。 比較のため、光学系から水を除去し空気中で 露光を行ったところ、解像限界は0.15μm に後退し、本発明の効果が確認された。

【0019】(実施例3)実施例2の投影既光装置において、図4に示す様に光学系側と基板側とを石英の平行平板31により分割した。これにより、基板を光学系に対して走査したりステップ送りしたときに生じる液体媒質の流れが光学系側に及ぶことがないため、屈折率の裾

5

らぎ等の影響が抑えられてパターンの寸法精度が向上し た。なお、石英窓挿入により発生する球面収差に対して は、あらかじめ補正を行った。

【0020】 (実施例4) 実施例2の投影露光装置にお いて、図5に示す様に光学系と基板の間に石英平行平板 32, 33を設け、液体容器を光学系側液体容器34と 基板側液体容器35に分割した。更に基板5の光学系に 対する走査又はステップ送りを、基板側液体容器35ご と行うようにした。これにより、基板近傍での液体の流 れも抑制することができるため、屈折率の揺らぎ等の影 10 響が抑えられてパターンの寸法精度が更に向上した。

【0021】なお、本実施例による構成を実施例1に適 用する場合、マスク側にも同様の機構を設けることがで きる.

#### [0022]

[発明の効果] 本発明によれば、マスクパターンを投影 光学系により基板上へ結像させることにより上記基板上 にパターンを転写する際、投影光学系を反射型レンズを 含む光学系により構成するとともに、基板表面と投影光 学系の間を含む投影光学系の光路の全体又は一部を、光 20 光、13…ビーム整形光学系、14…液体容器。

の波長における空気に対する比屈折率が1より大きな媒 質で満たすことにより、従来型の露光装置の構成と光学 系を大きく変更することなく、簡便に実効的に短波長化 したのと同等の解像力向上を図ることができる。これに より、光リソグラフィの解像限界を30%程度向上し、 0.15μm 以下のパターンを形成することが可能とな

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理の説明図。

【図2】本発明の一実施例による露光装置の説明図。

【図3】本発明の第二の実施例による露光装置の説明

【図4】本発明の第三の実施例による露光装置の説明

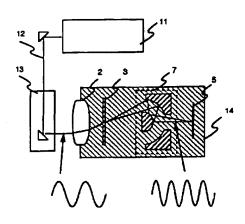
【図5】本発明の第四の実施例による露光装置の説明

#### 【符号の説明】

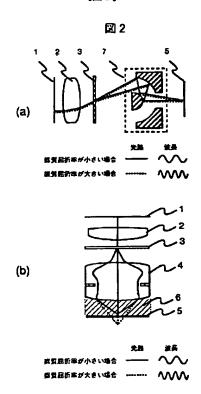
2…服明光学系、3…マスク、5…基板、7…反射型縮 小投影レンズ、11…エキシマレーザ、12…レーザ

[図1]

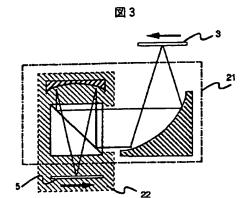
図1



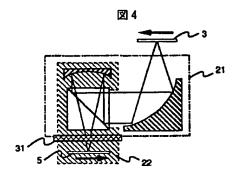
[図2]







[図4]



[図5]

